

第3回講演会のお知らせ

熱マネジメント材料の革新へ：フォノン・エンジニアリングと
マテリアルズ・インフォマティクス

本講演では、半導体・データセンター・EV等で重要性が高まる熱マネジメントを背景に、ナノ構造や界面を設計ノブとして活用するフォノン・エンジニアリングの考え方と、低熱抵抗接合や高熱伝導複合材などの研究事例を紹介する。さらに、熱機能材料の探索・最適化を加速するマテリアルズ・インフォマティクス、実験自動化、スケーリング則、産業応用に向けた課題設定力の重要性について展望する。

講師

東京大学
大学院工学系研究科教授
塩見 淳一郎 先生

2026
9/15 日

16:00-17:30

工学研究科 センター
スクエア サイエンス
キャンパスホール
【オンライン併用】

アクセス



略歴:東北大学卒業後、スウェーデン王立工科大学にてPhDを取得し、東京大学へ。2017年より同大学大学院工学系研究科教授を務めている。この間、日本機械学会フェロー、日本工学アカデミー会員、日本熱電学会理事を歴任するほか、Zeldovich Medal、日本伝熱学会学術賞、日本学術振興会賞、Nukiyama Memorial Award、文部科学大臣表彰科学技術賞などを受賞。専門は分子熱工学で、熱伝導、相変化、熱電変換、熱放射、界面流体現象の基礎研究から、熱エネルギーマネジメントの応用研究までを行っている。例えば、理論・数値解析、物性測定、構造設計、機械学習の4つのアプローチを組み合わせたフォノンエンジニアリングやマテリアルズ・インフォマティクスによって、材料の機能性を革新する研究に取り組み、様々な企業との共同研究やスタートアップ起業を行っている。

こちらのアドレスまたは左記QRコードよりご確認ください。

<https://www.eng.tohoku.ac.jp/map/?menu=campus&area=c&build=05>

参加申込

会場参加は学内の方に限らせていただきます。学外の方はオンラインでご参加ください。参加をご希望の方は、下記Googleフォームよりお申込みください。

<https://forms.gle/AyjTeLwHUM4aroYB7>

